



科研产出

- 论文 >
- 专利 >
- 专著 >

当前位置 > 首页 > 科研工作 > 科研产出 > 专利

专利名称:	一种TSV填孔方法
专利类别:	发明专利
申请号:	201310753329.0
申请日期:	2013-12-31
专利号:	201310753329.0
第一发明人:	于中尧
实施情况:	授权
专利证书号:	201310753329.0
其它备注:	封装中心

